

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成23年3月24日(2011.3.24)

【公開番号】特開2009-220405(P2009-220405A)

【公開日】平成21年10月1日(2009.10.1)

【年通号数】公開・登録公報2009-039

【出願番号】特願2008-67420(P2008-67420)

【国際特許分類】

B 28 D 5/00 (2006.01)

B 28 D 1/24 (2006.01)

【F I】

B 28 D 5/00 Z

B 28 D 1/24

【手続補正書】

【提出日】平成23年2月3日(2011.2.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

脆性材料基板上に形成された機能領域を各機能領域毎に分断して製品基板とするためスクライプするスクライプ装置であって、

前記脆性材料基板は、スクライプするライン毎に対応するアライメントマークが設定されたものであり、

前記スクライプ装置は、

前記脆性材料基板が設置されるテーブルと、

前記テーブル上の脆性材料基板に対向するように昇降自在に設けられ、その先端にスクライビングホイールを保持するスクライプヘッドと、

前記スクライビングホイールを前記脆性材料基板の表面に押圧した状態で前記スクライプヘッド及び脆性材料基板を相対的に移動させる移動手段と、

前記脆性材料基板のスクライプすべきラインの端部に設けられたアライメントマークを撮影するカメラと、

スクライプするラインを含むレシピデータテーブルをあらかじめ保持し、前記レシピデータテーブルに基づいて前記移動手段により脆性材料基板に設けられている一対のアライメントマークを結ぶラインに一致するように脆性材料基板を相対的に移動させると共に、前記スクライプヘッドを昇降させてスクライプを行うコントローラと、を具備するスクライプ装置。

【請求項2】

前記スクライプヘッドは、高浸透型のスクライビングホイールを用いた請求項1記載のスクライプ装置。

【請求項3】

脆性材料基板上に形成された機能領域を各機能領域毎に分断して製品基板とするためスクライプを形成するスクライプ方法であって、

前記脆性材料基板は、スクライプするライン毎に対応するアライメントマークが設定されたものであり、

スクライブライン毎に前記脆性材料基板に設けられた一対のアライメントマークを検出

し、

前記一対のアライメントマークを通るラインをスクライプするように前記テーブルを移動し、

スクライプヘッドを脆性材料基板上に降下させて、前記アライメントマークを結ぶラインに沿って前記脆性材料基板をスクライプするスクライプ方法。